

最新の「冷却技術」をテーマにした研究会

2026年2月2日 [月] 13時30分～16時50分

京都府産業支援センター 5F 研修室

参加無料

現在注目を集めているAI・半導体関連ですが、今回はAI普及によるデータセンターやEV、半導体関連に不可欠な熱冷却に関する課題を研究会形式で話し合う会を開催します。ぜひご参加ください。

・受付開始 13:00～

・開会 13:30

・第1部 冷却紹介 13:35～15:05

1) 三洋化成工業株式会社 13:35～14:05

ウレタン系放熱ギャップフィラー

『サーマップシリーズ』のご紹介

ウレタン材料事業本部 営業部 応用製品営業グループ

主任 能勢 謙太 氏

2) 株式会社最上インクス 14:05～14:35

薄板金属製フレキシブル伝熱フィンによる熱課題解決

新事業推進部 部長 福田 真弘 氏

3) 株式会社ジーマックス 14:35～15:05

ジーマックス熱電半導体事業のご案内

代表取締役 高井 淳治 氏

・第2部 交流会 15:20～16:50

■ 参加申込



QRコードを読み取り、
必要事項をご記入のうえ、
申込みをお願いします。
※定員30名程度

■ アクセス



JR嵯峨野線
丹波口駅から
徒歩5分

■ 主催・共催

主催：公益財団法人 京都産業21 共催：京都府中小企業技術センター

■ お問合せ

公益財団法人 京都産業21 イノベーション統括本部 イノベーション推進部

電話：075-315-8677 メール：semicon@ki21.jp